

华润微电子有限公司
投资者关系活动记录表
(2023 年 1 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☒ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	1 月 05 日 13:00-14:00 MORGAN STANLEY、AMUNDI ASSET MANAGEMENT、BROAD PEAK INVESTMENT ADVISORS、DESTINATION PARTNERS、GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT、INTERPRETER、MILLENNIUM PARTNERS、REDWHEEL、SEATOWN HOLDINGS、T ROWE PRICE、UG INVESTMENT ADVISORS 1 月 05 日 15:00-16:00 CPPIB、cyberatlas capital、EdRAM、FIL International、Fosun、FRANKLIN TEMPLETON EM、Grand Alliance、Green Court Capital、Hel Ved Capital、hony capital / goldstream、JP Morgan、JQ Asset、Kadensa、Lazard Asset、manulife、MLP、NBIM、NOC、Ortus Capital、P72、polymer、Power Pacific、Schonfeld、sequoia、Snow Lake、Springs capital、SuMi Trust、Telligent、Tiger Pacific Capital、Torq、Trilogy Partners Ltd.、Trivest advisors、Wellington、WT、鹏扬基金 1 月 06 日 15:30-16:30 中金公司、CCB AM、中信产业投资、FRANKLIN TEMPLETON

	INVESTMENTS (ASIA)、 Fullgoal Fund 、 Green Court Capital、 Lingren Investment、 LONGRISING PROSPEROUS CHINA FUND、 MassAve Global、 Pinpoint 、 TEN FUND、 Triata Capital、 北京程越康越投资、 北京龙鼎投资、 北京禹田资本、 财通证券、 承珞(上海)投资、 敦和资产、 三鑫资产、 亘曦资产、 古木投资、 国海证券、 国华兴益保险资产、 国泰君安证、 杭州凯昇投资、 灏浚投资、 和沣资本、 华安基金、 华宝基金、 华夏未来资本、 汇丰晋信基金、 江西彼得明奇资产、 交银康联资产、 交银施罗德基金、 平安资产管理、 厦门原点投资、 山西证券、 陕西星河璨云资产、 上海砥俊资产、 上海顶天投资、 上海峰境私募基金、 上海恒穗资产、 上海嘉世私募基金、 上海健顺投资、 上海久期投资、 上海聆泽投资、 上海留仁资产、 上海拓璞投资、 上海潼骁投资、 上海中域投资、 上银基金、 申万宏源证券、 深圳嘉石大岩资本、 深圳前海承势资本管理、 深圳前海道谊投资、 深圳前海固禾资产、 深圳市平石资产、 深圳市平石资产、 深圳市千榕资产、 深圳市勤道资本、 深圳市尚诚资产管理、 深圳市尚诚资产管理、 深圳市唯德投资、 深圳市允泰投资、 深圳天风天成资产、 深圳天际线投资、 深圳幸福时光私募证券、 拾贝投资、 太平保险资管、 天钺控股、 天弘基金、 养生堂、 银湖资产、 永赢基金、 誉辉资本、 长见投资、 正奇控股、 中荷人寿保险、 中融信托、 中信期货资管、 中邮证券、 珠海坚果私募基金、 珠海市榕仁投资 1 月 16 日 14:00-15:00 J.P.Morgan、 Point 72、 BNP Paribas、 Torq Capital、 Fountain Capital、 China Investment Corp、 PinPoint
时间	1 月 05 日 13:00-14:00, 15: 00-16: 00 1 月 06 日 15:30-16:30 1 月 16 日 14:00-15:00
地点	华润微电子会议室（电话会议）

上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子投资者关系高级经理
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司 2023 年资本性支出是怎样的？主要是哪些项目？ 答：2023 年资本性开支较 2022 年会有增加，主要是重庆 12 吋、深圳 12 吋、先进功率封测基地以及公司对外投资并购项目。 问题二：公司目前消费类和工控类的占比情况，2023 年一季度消费类订单需求是否有好转？ 答：公司工控及汽车电子在营收中的占比不断提升，占比近 50%。消费类目前尚未见明显好转，预计 2023 年二季度后景气度会呈上行调整状态。 问题三：请问重庆 12 吋产线规划做什么产品，规划产能多少，目前是否已经通线，通线产品是什么？ 答：公司重庆 12 吋产线规划产品是功率器件包括 MOSFET 和 IGBT，整体产能规划 3-3.5 万片/月，目前包括低压沟槽 SGT MOS，高压超结 SJ MOS 在内四类产品均实现通线，项目进入产品投产流通与产能建设上量并行阶段。 问题四：公司深圳 12 吋预计什么时间通线？产线产能规划多少？ 答：深圳 12 吋产线预计 2024 年年底实现通线投产，满产后将形成年产 48 万片 12 吋功率 IC 芯片的生产能力。 问题五：目前公司 6 吋和 8 吋产能内部自用和外部客户代工是如何分配的？ 答：6 吋产线自用和外部客户代工比例基本各 50%，8 吋产线有 2 条，无锡 8 吋产线约 80%用于外部客户代工，重庆 8 吋产线全部自用。 问题六：可否介绍下目前公司车规级产品的进展？ 答：公司在 2022 年 12 月 14 日发布了 43 颗车规级产品，产

	品包括 IGBT、SGT MOS、SJ MOS、SiC JBS、SiC MOS、IGBT 模块、SJ MOS 模块以及 SiC MOS 模块，积极推进车规级产品应用。 问题七： 公司掩模业务也受到大家的关注，可否介绍下公司掩模业务？公司掩模产品主要针对哪些领域？ 答：公司掩模产能目前 2000 片/月，公司掩模业务已服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司，高端掩模项目已在建设中，规划产能 1000 片/月，预计在 2024 年一季度可提供 40nm 及以上线宽的掩模代工服务。 问题八：公司有产品与方案、制造与服务两块业务，这两块业务的占比情况如何，产品与方案即 IDM 业务的产品结构分布情况可否介绍一下？未来增速如何？ 答： IDM 业务主要是指产品与方案板块，在营收中的占比近 50%，其中 40%左右属于功率半导体，功率半导体包括功率器件（MOSFET、IGBT、SBD、FRD 等产品）以及功率 IC，目前 MOS 在营收中占比较高，IGBT 增速较快，未来比重会增加；第三代半导体的比重也会逐步提升。 问题九：按照公司发展战略和规划，未来会一直按照 IDM+代工的路线发展吗？ 答：公司致力于向综合一体化产品公司转型，产品发展速度会快于代工。产品方面我们会给予更多资源倾斜，另一方面收购兼并业务也会重点放在产品上面，未来目标是产品业务占比达到 65%-70%。 问题十： IGBT 产品目前下游应用结构可否介绍一下？ IGBT 模块是否有上量？ 预计什么时候可以进入汽车主驱？ 答： IGBT 产品下游应用结构为工控占比 65%，汽车占比 20%，消费类占比 15%，IGBT 模块目前已经上量，预计 2023 年 IGBT 产品能够进入汽车主驱。 问题十一： 请介绍下公司宽禁带半导体 SiC 发展情况？ 下
--	---

游应用？是否进入汽车电子应用？公司是否有布局 SiC 衬底和外延？

答：公司碳化硅产品二极管和 MOS 均已系列化上量，SiC 产品在汽车电子、充电桩、工业电源等方面应用较多，SiC 二极管有导入新能源汽车 OBC 应用，SiC MOSFET 产品以及 SiC 模块产品在验证中。SiC 产品没有布局衬底和外延，公司会通过战略投资去做这两个方面的布局。

问题十二：从产品结构、产能、订单的角度来看，哪一块是公司今年收入增长的主要动力？

答：增长主要动力还是会来自于 IDM 业务，IDM 业务会保持比较快的增长。

问题十三：公司晶圆制造、封测以及掩模的占比大概是多少？

答：从公司 2022 年前三季度数据来看，晶圆制造在整体营收中的占比大约 32%，封测占比 16%，掩模占比约 3%。

问题十四：可否介绍下公司面板级封装，跟 Chiplet 是否类似？

答：公司开发的面板级扇出封装技术，采用载板级 RDL 加工方案，是 Chiplet 封装的基础工艺，不但可以实现低成本 interposer 的加工，也可以完成 HI 系统级封装的最终整合。一方面有效解决 Chiplet 封装成本高昂的问题，更适用于功率类半导体封装异构集成化。

问题十五：听说公司并购了润新微电子，是专门做 GaN 产品的，相关情况可否介绍一下？产品是否量产，主要应用是什么？

答：润新微电子目前主要是在公司现有生产线做氮化镓产品。2022 年 9 月份公司向市场发布了 GaN 650/900V 系列化产品，目前 GaN 产品已经规模上量并贡献一定的销售额。产品主要应用网通电源适配器，伺服电机电源，服务器电源，

	电网电表，助力车充电器，LED 电源等 问题十六：公司功率 IC 主要有哪些产品？MCU 主要应用是什么？ 答： 公司功率 IC 主要包括 LED 驱动、电源、电机驱动、功放电路、BMS、AC-DC、DC-DC、无线充等；MCU 主要是工控（如仪器仪表）、消费（如家电）应用为主，汽车方面在积极布局，产品尚未进入汽车应用。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 30 日